

高熱伝導性プリント配線板

高熱伝導性CEM-3プリント配線板

<基 材>

R-1787(パナソニック株製)

熱伝導率 1.1W/mK

板 厚...1.0, 1.6mm 銅箔厚...18, 35, 70 μ m

高熱伝導性FR-4プリント配線板

<基 材>

CS-3945(利昌工業株製)

熱伝導率 1.3W/mK

板 厚...0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.6mm

銅箔厚...18, 35, 70 μ m

一般特性(実測値)

項目	条件	単位	R-1586(H)	R-1787	CS-3945
基板熱伝導		W/mK	1.50	1.10	1.3
CTE	X < Tg	ppm/°C	18	17	13
	Y < Tg		21	19	14
	Z < Tg		45	50	20-30
	Z > Tg		210	135	130-150
貫層耐電圧		KV/mm	41	43	-
絶縁抵抗		M Ω	5 \times 10 ⁸	1 \times 10 ⁸	3 \times 10 ⁸
比誘電率	1MHz	-	5.2	5.1	7.0
誘電正接	1MHz	-	0.020	0.016	0.015
はんだ耐熱性	260°C	Sec	120以上	120以上	300以上
Tg	DMA	°C	155	190	140
耐トラッキング性	IEC法	-	600以上	600以上	600以上

cgk

株式会社ちの技研

ISO9001
認 証

ISO14001
認 証